

## 北京君正集成电路股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

近期，为保证北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及其分公司英属开曼群岛商矽成科技股份有限公司台湾分公司（以下简称“ISSI开曼台湾分公司”）、Integrated Silicon Solution Israel, Ltd.（以下简称“ISSI以色列”）、络明芯微电子国际有限公司（以下简称“络明芯国际”）的生产经营需要，公司全资子公司北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（以下简称“TSMC”）就三家子公司及其分公司向TSMC采购订单需支付的货款提供担保，并签署了《财务保证和担保书》（以下简称“本协议”）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，北京矽成已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、英属开曼群岛商矽成科技股份有限公司台湾分公司

成立日期：2012年1月3日

注册地点：新北市汐止区新台五路1段106号7楼

法定代表人：刘伟平

主营业务：电子材料批发业、电子材料零售业

与本公司的关系：公司下属全资子公司的分公司

是否为失信被执行人：否

## 2、Integrated Silicon Solution Israel, Ltd.

成立日期：1999年8月19日

注册地点：38 Habarzel Street, Tel Aviv, 6971054 Israel

注册资本：27,201,598美元

主营业务：标准一般权限

与本公司的关系：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

## 3、络明芯微电子国际有限公司

成立日期：2005年3月21日

注册地点：香港九龙观塘成业街6号泓富广场8楼801-5室

法定代表人：刘强

注册资本：1290美元

主营业务：集成电路产品的生产、销售、一般贸易等

与本公司的关系：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

## 三、担保协议的主要内容

1、担保生效日期：2025年4月1日

2、担保期间：自本协议签订之日起两年

3、保证范围：从生效日期起，北京矽成和签发采购订单的ISSI开曼台湾分公司、ISSI以色列或络明芯国际应共同和单独承担采购订单项下对TSMC的所有付款义务。

4、北京矽成在本协议项下的义务独立于三家子公司及其分公司的义务，无论TSMC是否对三家子公司及其分公司提起诉讼，TSMC均可对北京矽成提起单独诉讼。

## 四、累计及逾期对外担保的情况

截止本公告披露日，公司及子公司未发生因未支付应付到期贷款等而导致担保方支付费用的情形。

截止本公告披露日，公司子公司累计对子公司提供的实际担保发生金额为0元，公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担

保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、风险提示

本次公司全资子公司北京矽成向 TSMC 所提供担保的三家公司均为北京矽成全资子公司或全资子公司的分公司，北京矽成与上述三家公司共同和单独承担采购订单项下对 TSMC 的所有付款义务。截止本公告披露日，北京矽成累计对子公司提供的实际担保发生金额为 0 元。敬请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1、财务保证和担保书。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日